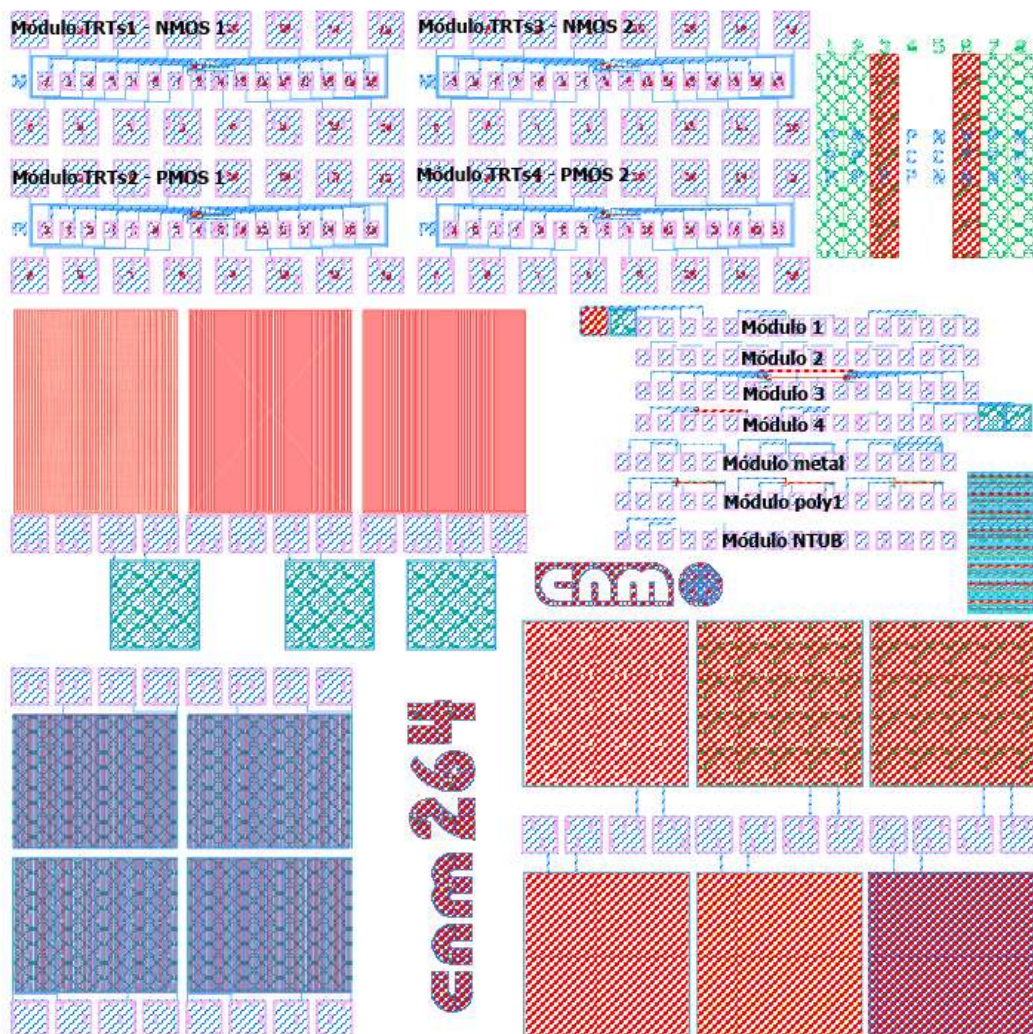


## ANEXO I. Información de medidas

### Condiciones de medida

- Para poder realizar todas las medidas CMOS se utiliza un sistema automático de cartografía con el programa ICV, la mesa de puntas Suss PA200 y sistema de medida Agilent 41000.
- El sistema lo dejamos en 'Quiet mode' para medir.
- Se utiliza el fichero de mapa: cmos264.map
- Se utiliza el fichero de test: CMOS\_all.die (diescripts)



## **Fórmulas**

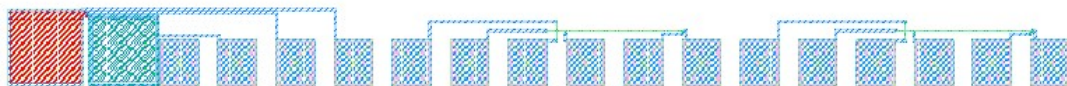
Se obtienen los siguientes valores de cada cartografía:

<b>Valor</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidades</b>
VTN30, VTP30, VTN30x3, VTP30x3, VTFN y VTFP	Tensión umbral de transistores: 30x30 de canal N, 30x30 de canal P, 30x3 de canal N, 30x3 de canal P, de campo de canal N y de campo de canal P. Se obtienen sobre las estructuras de transistores que se encuentran en la tira de test TT25, módulo 3.	V
BETAN30, BETAP30, BETAN30x3 y BETAP30x3	Ganancias de transistores: 30x30 de canal N, 30x30 de canal P, 30x3 de canal N, 30x3 de canal P. Se obtienen sobre las estructuras de transistores que se encuentran en la tira de test TT25, módulo 3.	$\mu\text{A}/\text{V}^2$
IOFFN30, IOFFP30	Corriente de fugas para transistores: 30x30 de canal N, 30x30 de canal. Se obtienen sobre las estructuras de transistores que se encuentran en la tira de test TT25, módulo 3. $I_{\text{off}} = \log_{10}(I_{\text{DS}})$ Condiciones medida: trt N: $V_{\text{DS}}=5\text{ V}$ , $V_{\text{GS}}=0\text{ V}$ ; trt P: $V_{\text{DS}}=-5\text{ V}$ , $V_{\text{GS}}=0\text{ V}$	
R#N+, R#P+, R#P0 R#P1, R#M1, R#NTUB y R#P1AA	Resistencia por cuadro de áreas activas N+, P+, poly0, poly1, metal, pozo y poly1 en área activa. Se obtienen sobre las estructuras CBR que se encuentran en la tira de test TT25, módulo 1, módulo 4, módulo metal, módulo pozo y módulo poly1. $R_s = \frac{\pi}{\ln 2} \cdot \frac{V}{I}$	$\Omega$
DWN+, DWP+, DWP0, DWP1, DWM1, DWNTUB y DWP1AA	Anchura en líneas N+, P+, poly1, metal, pozo y poly1 en área activa. Se obtienen sobre las estructuras CBR que se encuentran en la tira de test TT25, módulo 1, módulo 4, módulo metal, módulo pozo y módulo poly1. $W = \frac{R_s}{R} \cdot L = \frac{I}{V} \cdot L \cdot R_s = W_0 \cdot R_s \quad (L=300\text{ }\mu\text{m})$	$\mu\text{m}$
RCMP0, RCMP1, RCMP+ y RCMN+	Resistencias de contacto entre metal y poly0, metal y poly1, metal y P+ y metal y N+. Se obtienen sobre las estructuras kelvin que se encuentran en la tira de test TT25, módulo 2. $R_c = \frac{V}{I}$	$\Omega$

LEFFN y LEFFP	<p>Longitud efectiva de canal de transistor de canal N y canal P. Se obtiene a partir de la representación de <math>L=f(1/I_{DS})</math> para los transistores de la tabla 6. Se calcula la regresión lineal. El corte de la recta con eje Y (valor de a) representa el valor de <math>\Delta L</math>. LEFF (longitud efectiva del transistor de longitud 3) = <math>3 - \Delta L</math></p> $a = \frac{\sum y - b \cdot \sum x}{n}, \quad b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - \sum x \cdot \sum x}; \quad x = \frac{1}{I_{ds}}, \quad y = L$	$\mu m$
---------------	--	---------

## **Tira de test TT25**

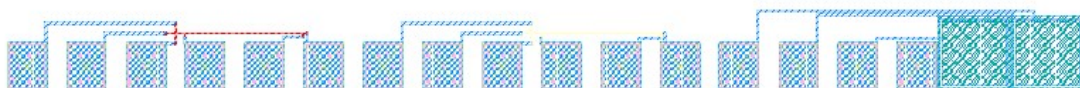
### **• Estructuras CBR**



*Figura 1.* Módulo 1 de la tira de test TT25 que contiene estructuras CBR.

Niveles	Pads
N+	5-10
P+	11-16

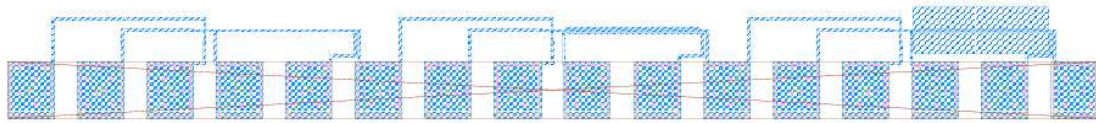
*Tabla 1.* Distribución de pads de las estructuras CBR en el módulo 1.



*Figura 2.* Módulo 4 de la tira de test TT25 que contiene estructuras CBR.

Niveles	Pads
Poly1	1-6
Poly0	7-12

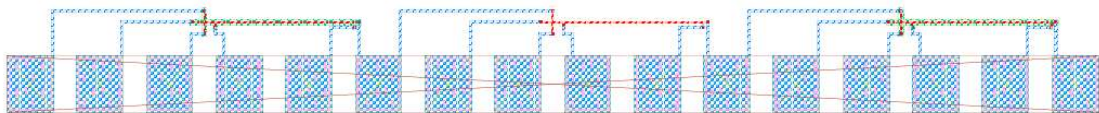
*Tabla 2.* Distribución de pads de las estructuras CBR en el módulo 4.



*Figura 3.* Módulo metal de la tira de test TT25 que contiene estructuras CBR de metal.

Niveles	Pads
Metal	1-6
Metal vecindad delgada	6-11
Metal vecindad gruesa	11-16

*Tabla 3.* Distribución de pads de las estructuras CBR en el módulo metal.



*Figura 4.* Módulo cbr poly1 de la tira de test TT25 que contiene estructuras CBR poly1.

Niveles	Pads
Poly1 óxido puerta P	1-6
Poly1 óxido puerta N	6-11
Poly1 en área activa	11-16

*Tabla 4.* Distribución de pads de las estructuras CBR poly1.



*Figura 5.* Módulo cbr pozo de la tira de test TT25 que contiene estructura CBR pozo.

Niveles	Pads
NTUB	1-6

*Tabla 5.* Distribución de pads de las estructuras CBR pozo.

## · Estructuras Kelvin

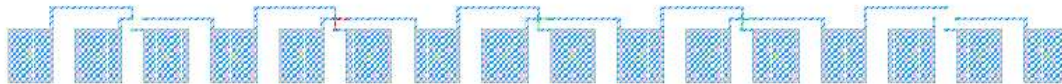


Figura 6. Módulo 2 de la tira de test TT25 que contiene las estructuras Kelvin.

Niveles	Pads
Metal-polisilicio 0	1-4
Metal-polisilicio 1	4-7
Metal-N <sup>+</sup>	7-10
Metal-P <sup>+</sup>	10-13

Tabla 6. Distribución pads de las estructuras Kelvin en el módulo 2.

## · Estructuras transistores:

- para medidas V<sub>TH</sub>, BETA, I<sub>OFF</sub>

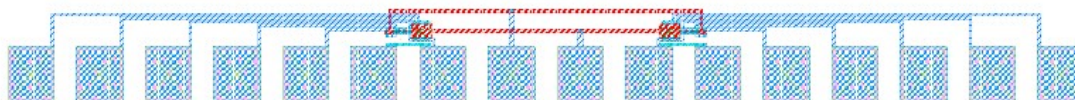


Figura 7. Módulo 3 de la tira de test TT25 que contiene los transistores.

Pad		W/L	
1	Drain	30/30	NMOS
2	Drain	3/30	NMOS
3	Drain	3/3	NMOS
4	Drain	30/3	NMOS
5	Drain	3/3	NMOS campo
6	Bula		NMOS
7	Source		NMOS
8	Gate		campo
9	Gate		
10	Source		PMOS
11	Bula		PMOS
12	Drain	3/3	PMOS campo
13	Drain	30/3	PMOS
14	Drain	3/3	PMOS
15	Drain	3/30	PMOS
16	Drain	30/30	PMOS

Tabla 7. Distribución de pads de los distintos transistores en el módulo 3.



- para medidas LEFF

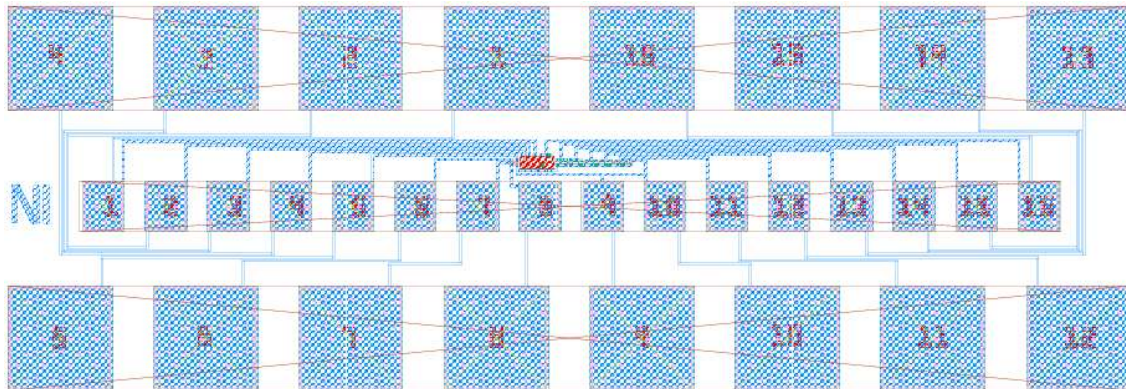


Figura 8. Módulo TRTs1 de la tira de test TT25. Contiene los transistores canal N.

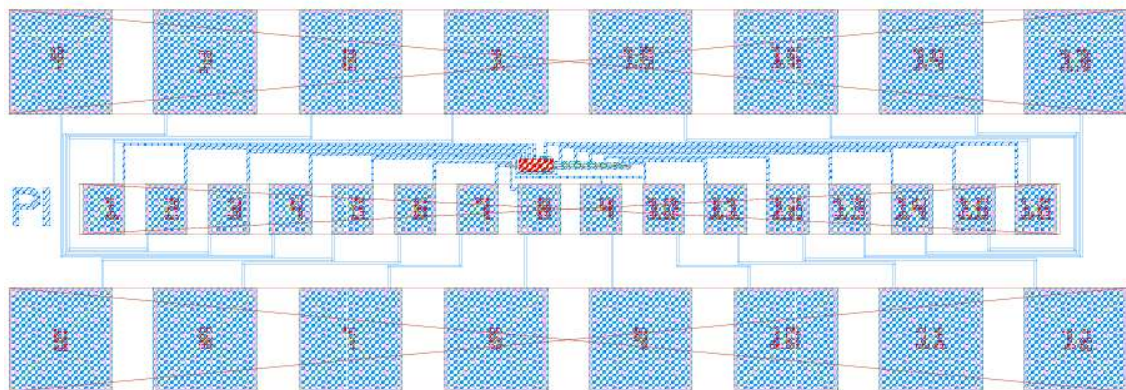


Figura 9. Módulo TRTs2 de la tira de test TT25. Contiene los transistores canal P.

Pad		W/L
1	Drain	3.5/30
2	Drain	5/30
3	Drain	3/30
4	Drain	2.5/30
5	Drain	2.5/3
6	Drain	3/3
7	Gate	
8	Source	
9	Bulk	
10	Drain	3.5/3
11	Drain	30/3
12	Drain	30/3.5
13	Drain	30/4
14	Drain	30/4.5
15	Drain	30/5
16	Drain	30/30

Tabla 8. Distribución de los transistores para los módulos TRTs1 (NMOS) y TRTs2 (PMOS)

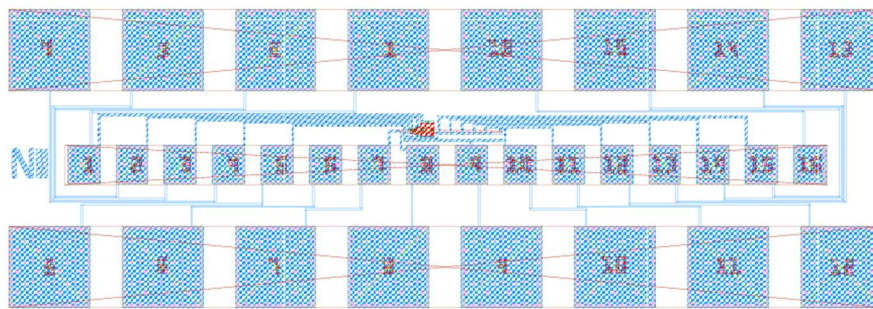


Figura 10. Módulo TRTs3 de la tira de test TT25. Contiene los transistores canal N II.

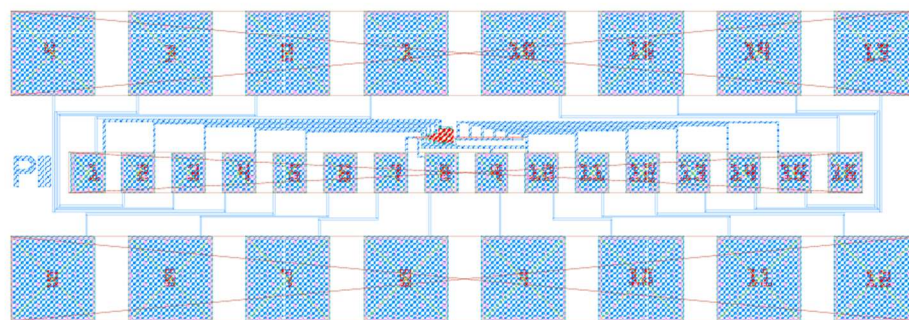


Figura 11. Módulo TRTs4 de la tira de test TT25. Contiene los transistores canal P II.

Pad		W/L
1	Drain	40/40
2	Drain	10/20
3	Drain	10/10
4	Drain	5/5
5	Drain	5/4
6	Drain	X
7	Gate	
8	Source	
9	Bulk	
10	Drain	2.5/3.5
11	Drain	3/3.5
12	Drain	3.5/3.5
13	Drain	2.5/4
14	Drain	3/4
15	Drain	3.5/4
16	Drain	X

Tabla 9. Distribución de los transistores para los módulos TRTs3 (NMOS) y TRTs4 (PMOS)